SEMICONDUCTOR LASER

Patent Number:

JP6334272

Publication date:

1994-12-02

Inventor(s):

NAKANO KAZUSHI; others: 03

Applicant(s):

SONY CORP

Requested Patent:

☐ JP6334272

Application Number: JP19930184436 19930629

Priority Number(s):

IPC Classification: H01S3/18; H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To achieve blue or green light emission using ZnMgSSe compound semiconductor as a clad layer by constituting a first clad layer, a first optical waveguide layer, an active layer, a second optical waveguide, and a second clad layer with a compound semiconductor shown by an expression and then forming the active layer to be a single quantum well layer with a specific thickness. CONSTITUTION:By forming a first clad layer 3 and a second clad layer 7 with ZnMgSSe compound semiconductor (x=0, b=0) in a compound semiconductor in an expression 1 (0<=x<1, 0<=y<1, 0<=a<1, 0<=b<1), the title semiconductor laser with SCH structure where blue or green light can be emitted using the ZnMgSSe compound semiconductor as the material of a clad layer can be achieved. Besides, an active layer 5 has a single quantum well layer 5b which is 2-20nm thick so that the title semiconductor laser has a low threshold current.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-334272

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

H01L 33/00

D 7376-4M

審査請求 未請求 請求項の数21 FD (全 18 頁)

(21)出願番号

特願平5-184436

(22)出願日

(32)優先日

平成5年(1993)6月29日

(31)優先権主張番号 特顧平5-86721

(33)優先権主張国

平5 (1993) 3月22日 日本 (JP)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 中野 一志

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 大畑 豊治

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 伊藤 哲

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 杉浦 正知

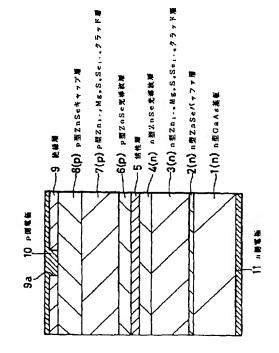
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体レーザー

(57)【要約】

【目的】 ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層 の材料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能な低 しきい値電流の半導体レーザーを実現する。

【構成】 n型GaAs基板1上にn型ZnSeバッフ ァ層2を介してn型Zni-p Mg, S, Sei-, クラッ ド層3、n型ZnSe光導波層4、活性層5、p型Zn Se光導波層 6 およびp型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッド層7を順次積層してレーザー構造を形成する。 括性層 5 は厚さが 2~20 nmの単一の i型 2 n₁₋₁ C d: Se量子井戸層から成るか、合計の厚さが2~20 nmの二つのi型Zni-: Cd: Se量子井戸層を含 t.



体レーザー。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 化合物半導体基板上に積層された第1導 電型の第1のクラッド層と、

上記第1のクラッド層上に積層された第1の光導波層 と、

上記第1の光導波層上に積層された活性層と、

上記活性層上に積層された第2の光導波層と、

上記第2の光導波層上に積層された第2導電型の第2の クラッド層とを有し、

層、上記第2の光導波層および上記第2のクラッド層は Zni-r-y Cd: Mg, S. Teb Sei-s-b (ただ $l, 0 \le x < 1, 0 \le y < 1, 0 \le a < 1, 0 \le b < 1$ 1) 系化合物半導体から成るとともに、

上記活性層は単一の量子井戸層を有し、かつ上記量子井 戸層の厚さは2~20nmであることを特徴とする半導 体レーザー。

【請求項2】 上記第1のクラッド層および上記第2の クラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成り、 Se系化合物半導体または2nSe系化合物半導体から 成り、上記活性層はZnCdSe系化合物半導体から成 る上記量子井戸層から成ることを特徴とする請求項1記 載の半導体レーザー。

【請求項3】 上記化合物半導体基板はGaAs基板で あり、上記第1のクラッド層はZnSeから成るパッフ ァ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1 のクラッド層および上記第2のクラッド層は0<p≤ 0. 2, $0 < q \le 0$. $3 \mathcal{O} Z n_{1-p} Mg_p S_q Se_{1-q}$ から成り、上記第1の光導波層および上記第2の光導波 30 と、 層は0 < u ≤ 0.1の2nS。Sei-』または2nSe から成り、上記活性層は0 < z ≤ 0. 3のZ ni-s C d . Seから成る上記量子井戸層から成り、上記第1のク ラッド層および上記第2のクラッド層と上記量子井戸層 との間のバンドギャップの差は0.25eV以上であ り、上記第1の光導波層および上記第2の光導波層と上 記量子井戸層との間のパンドギャップの差は0.1eV 以上であることを特徴とする請求項1記載の半導体レー

【請求項4】 上記第1のクラッド層および上記第2の 40 クラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成り、 上記第1の光導波層および上記第2の光導波層は2nM gSSe系化合物半導体から成り、上記活性層はZnS e系化合物半導体またはZnSSe系化合物半導体から 成る上記量子井戸層から成ることを特徴とする請求項1 記載の半導体レーザー。

【請求項5】 上記化合物半導体基板はGaAs基板で あり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッフ ァ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1

 ≤ 0.4 , 0. $15 \leq q \leq 0.4502 n_{1-p} Mg_{p} S$ 。Se1-。から成り、上記第1の光導波層および上記第 2の光導波層は0.05≦p≤0.15、0.1≦q≤ 0. 2のZn₁-, Mg, S, Se₁-, から成り、上記活 性層は2nSeから成る上記量子井戸層から成り、上記 第1のクラッド層および上記第2のクラッド層と上記量 子井戸層との間のパンドギャップの差は0、25eV以 上であり、上記第1の光導波層および上記第2の光導波 層と上記量子井戸層との間のパンドギャップの差は0. 上記第1のクラッド層、上記第1の光導波層、上記活性 10 1 e V以上であることを特徴とする請求項1記載の半導

【請求項6】 上記化合物半導体基板はGaAs基板で あり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッフ ァ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1 のクラッド層および上記第2のクラッド層は0.15≤ $p \le 0.5, 0.2 \le q \le 0.550 Z n_{1-9} Mg_9 S$ **、Seュ-。から成り、上記第1の光導波層および上記第** 2の光導波層は0. 1≤p≤0. 2、0. 15≤q≤ 0. 25のZn₁-。Mg。S。Se₁-。から成り、上記 上記第1の光導波層および上記第2の光導波層は2nS 20 括性層は0.01≤u≤0.1の2nS Se1-』から 成る上記量子井戸層から成り、上記第1のクラッド層お よび上記第2のクラッド層と上記量子井戸層との間のバ ンドギャップの差は0.25eV以上であり、上記第1 の光導波層および上記第2の光導波層と上記量子井戸層 との間のパンドギャップの差は0.1 c V以上であるこ

> 【請求項7】 化合物半導体基板上に積層された第1導 **電型の第1のクラッド層と、**

とを特徴とする請求項1記載の半導体レーザー。

上記第1のクラッド層上に積層された第1の光導波層

上記第1の光導波層上に積層された活性層と、

上記活性層上に積層された第2の光導波層と、

上記第2の光導波層上に積層された第2導電型の第2の クラッド層とを有し、

上記第1のクラッド層、上記第1の光導波層、上記活性 層、上記第2の光導波層および上記第2のクラッド層は Zn1-x-y Cdx Mgy S. Teb Se1-x-b (ただ $0, 0 \le x < 1, 0 \le y < 1, 0 \le a < 1, 0 \le b < 0$ 1) 系化合物半導体から成るとともに、

上記活性層は二つの量子井戸層を有し、かつ上記二つの 量子井戸層の合計の厚さは2~20 nmであることを特 徴とする半導体レーザー。

【請求項8】 上記第1のクラッド層および上記第2の クラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成り、 上記第1の光導波層および上記第2の光導波層は2nS Se系化合物半導体または2nSe系化合物半導体から 成り、上記活性層は2nCdSe系化合物半導体から成 る第1の量子井戸層、上記第1の量子井戸層上に積層さ れたZnSe系化合物半導体から成る障壁層および上記 のクラッド層および上記第2のクラッド層は $0.1 \le p$ 50 障壁層上に積層された2nCdSe 系化合物半導体から

成る第2の量子井戸層から成ることを特徴とする請求項 7記載の半導体レーザー。

【請求項9】 上記化合物半導体基板はGaAs基板で あり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッフ ァ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1 のクラッド層および上配第2のクラッド層は0<p≤ 0. 2. $0 < q \le 0$. $3 O Z n_{1-p} Mg_p S_q S e_{1-q}$ から成り、上記第1の光導波層および上記第2の光導波 層は0 < u ≤ 0. 1の2 n S。Se:-。または2 n Se : Seから成る第1の量子井戸層、上記第1の量子井戸 層上に積層された ZnSeから成る障壁層および上記障 壁層上に積層された0<z≤0.3のZni-, Cd, S eから成る第2の量子井戸層から成り、上記第1のクラ ッド層および上記第2のクラッド層と上記第1の量子井 戸層および上記第2の量子井戸層との間のバンドギャッ プの差は0.25eV以上であり、上記第1の光導波層 および上記第2の光導波層と上記第1の量子井戸層およ び上記第2の量子井戸層との間のパンドギャップの差は 半導体レーザー。

【請求項10】 上記第1のクラッド層および上記第2 のクラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成 り、上記第1の光導波層および上記第2の光導波層は2 nMgSSe系化合物半導体から成り、上記活性層はZ nSe系化合物半導体またはZnSSe系化合物半導体 から成る第1の量子井戸層、上記第1の量子井戸層上に 積層された乙nMgSSe系化合物半導体から成る障壁 層および上記障壁層上に積層された2nSe系化合物半 導体または2nSSe系化合物半導体から成る第2の量 30 子井戸層から成ることを特徴とする請求項7記載の半導 体レーザー。

【請求項11】 上記化合物半導体基板はGaAs基板 であり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッ ファ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第 1のクラッド層および上記第2のクラッド層は0.1≤ $p \le 0.4, 0.15 \le q \le 0.4502 n_{1-}, Mg_{0}$ S。Seュ-。から成り、上記第1の光導波層および上記 第2の光導波層は0.05≦p≦0.15、0.1≦q ≦0. 2のZn₁-, Mg, S, Se₁-, から成り、上記 40 -. 活性層は2nSeから成る第1の量子井戸層、上記第1 の量子井戸層上に積層された0.05≤p≤0.15、 0. 1≦q≦0. 2のZn₁-, Mg, Sq Se₁-q から 成る障壁層および上記障壁層上に積層されたZnSeか ら成る第2の量子井戸層から成り、上記第1のクラッド 層および上記第2のクラッド層と上記第1の量子井戸層 および上記第2の量子井戸層との間のパンドギャップの 差は0.25e V以上であり、上記第1の光導波層およ び上記第2の光導波層と上記第1の量子井戸層および上 記第2の量子井戸層との間のパンドギャップの差は0.

1 e V以上であることを特徴とする請求項7記載の半導 体レーザー。

【請求項12】 上記化合物半導体基板はGaAs基板 であり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッ ファ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第 1のクラッド層および上記第2のクラッド層は0.15 $\leq p \leq 0.5, 0.2 \leq q \leq 0.5502 n_{1-p} Mg_{p}$ Sc Sei-。から成り、上記第1の光導波層および上記 第2の光導波層は0. 1≦p≦0. 2、0. 15≦q≦ から成り、上記活性層は0 < z ≤ 0. 3のZ n₁-, C d 10 0. 25のZ n₁-, Mg, S, S e₁-, から成り、上記 活性層は0.01≤u≤0.1の2nS。Se₁-。から 成る第1の量子井戸層、上記第1の量子井戸層上に積層 $\Rightarrow 1500.15 = 1500.2$ Zni-, Mg, Sc Sei-c から成る障壁層および上記 障壁層上に積層された0.01≤u≤0.1の2nS。 S e 1 - 。 から成る第2の量子井戸層から成り、上記第1 のクラッド層および上記第2のクラッド層と上記第1の 量子井戸層および上記第2の量子井戸層との間のパンド ギャップの差は0.25e V以上であり、上記第1の光 0. 1 e V以上であることを特徴とする請求項7記載の 20 導波層および上記第2の光導波層と上記第1の量子井戸 層および上記第2の量子井戸層との間のパンドギャップ の差は0.1 e V以上であることを特徴とする請求項7 記載の半導体レーザー。

> 【請求項13】 化合物半導体基板上に積層された第1 導電型の第1のクラッド層と、

上記第1のクラッド層上に積層された活性層と、

上記活性層上に積層された第2導電型の第2のクラッド 層とを有し、

上記第1のクラッド層、上記活性層および上記第2のク ラッド層はZn:-x-y Cdx Mgy S. Te Se 1-1-b (ただし、 $0 \le x < 1$ 、 $0 \le y < 1$ 、 $0 \le a < 1$ 1、0≦b<1) 系化合物半導体から成るとともに、 上記活性層の厚さは15~60nmであることを特徴と

する半導体レーザー。

【請求項14】 上記第1のクラッド層および上記第2 のクラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成 り、上記活性層はZnSSe系化合物半導体、ZnSe 系化合物半導体またはZnCdSe系化合物半導体から 成ることを特徴とする請求項13記載の半導体レーザ

【請求項15】 上記化合物半導体基板はGaAs基板 であり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るパッ ファ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第 1のクラッド層および上記第2のクラッド層は0.1≦ $p \le 0.4$, 0. $15 \le q \le 0.4502 n_{1-p} Mg_{p}$ S。Sei-。から成り、上記活性層はZnSeから成 り、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層 と上記活性層との間のバンドギャップの差は0.25e V以上であることを特徴とする請求項13記載の半導体

50 レーザー。

【請求項17】 上記化合物半導体基板はG a A s 基板であり、上記第1のクラッド層はZ n S e から成るパッファ層を介して上記G a A s 基板上に積層され、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層は $0 . <math>2 < 0 < q \le 0$. 3 のZ n I - p M g p S c S e I - q から成り、上記活性層は $0 < z \le 0$. 3 のZ n I - p C d . S e から成り、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層と上記活性層との間のバンドギャップの差は0. 2 5 e V以上であることを特徴とする請求項13記載の半導体レーザー。

【請求項18】 化合物半導体基板上に積層された第1 導電型の第1のクラッド層と、

上記第1のクラッド層上に積層された活性層と、

上記括性層上に積層された第2導電型の第2のクラッド層とを有し、

上記第1のクラッド層、上記活性層および上記第2のクラッド層は Z_{n_1-1-1} Cd. Mg, S. Te Se 1-1-5 (ただし、 $0 \le x < 1$ 、 $0 \le b < 1$) 系化合物半導体から成るとともに、

上記活性層は複数の量子井戸層を有し、かつ上記複数の 30 量子井戸層の合計の厚さは10~35nmであることを 特徴とする半導体レーザー。

【請求項19】 上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層はZnMgSSe系化合物半導体から成り、上記活性層は交互に積層されたZnSSe系化合物半導体がら成る複数の障壁層およびZnSe系化合物半導体から成る複数の量子井戸層から成ることを特徴とする請求項18記載の半導体レーザー。

【請求項20】 上記化合物半導体基板はGaAs基板 40であり、上記第1のクラッド層はZnSeから成るバッファ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層は $0.1 \le p \le 0.4$ 、 $0.15 \le q \le 0.45$ の Zn_{1-p} Mg, S_cSe_{1-c} から成り、上記活性層は交互に積層された $0.05 \le p \le 0.4$ 、 $0.1 \le q \le 0.45$ の Zn_{1-p} Mg, S_cSe_{1-c} から成る複数の障壁層および Zn_{1-p} Mg, S_cSe_{1-c} から成る複数の障壁層および Zn_{1-p} Mg, S_cSe_{1-c} から成る複数の障壁層および Zn_{1-p} Mg, S_cSe_{1-c} から成る複数の量子井戸層から成り、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層と上記量子井戸層との間のバンドギャップの差は0.25eV以上であ50

り、上記障壁層と上記量子井戸層との間のバンドギャップの差は0.1 e V以上であることを特徴とする請求項18記載の半導体レーザー。

6

【請求項21】 上記化合物半導体基板はGaAs基板であり、上記第1のクラッド層は2nSeから成るバッファ層を介して上記GaAs基板上に積層され、上記第1のクラッド層は3元と記第2のクラッド層は0.15 ≤p≤0.55のZn1-, Mg, ScSe1-。から成り、上記括性層は交互に積層された100.1≤p≤0.55のZn1-。Mg。ScSe1-。から成る複数の障壁層および0くu≤0.1のZnS。Se1-。から成る複数の障壁層および0くu≤0.1のZnS。Se1-。から成る複数の量子井戸層から成り、上記第1のクラッド層および上記第2のクラッド層と上記量子井戸層との間のパンドギャップの差は0.25eV以上であり、上記障壁層と上記量子井戸層との間のパンドギャップの差は0.1eV以上であることを特徴とする請求項18記載の半導体レーザー。

【発明の詳細な説明】 【0001】

② 【産業上の利用分野】この発明は、半導体レーザーに関し、特に、青色ないし緑色で発光が可能な半導体レーザーに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、光ディスクの記録密度の向上やレーザープリンタの解像度の向上を図るために、短波長での発光が可能な半導体レーザーに対する要求が高まってきており、その実現を目指して研究が活発に行われている。

【0003】このような短波長での発光が可能な半導体レーザーの作製に用いる材料としては、II-VI族化合物半導体が注目されている。そして、最近になって、II-VI族化合物半導体の一種であるZnSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いて発振波長が490~520nmの青色ないし緑色発光の半導体レーザーを実現することができたとの報告がなされている(例えば、日経エレクトロニクス、1992年4月27日号、no.552、第90頁~第91頁)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、ZnSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いて青色ないし緑色で発光が可能な半導体レーザーは実現されているが、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いて青色ないし緑色で発光が可能な半導体レーザーを実現することは困難であった。

【0005】従って、この発明の目的は、2nMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能でしかも低しきい値電流の半導体レーザーを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】乙nSe括性層の上下を

n型ZnMgSSeクラッド層とp型ZnMgSSeク ラッド層とで挟んだDH構造(Double Heterostructur e)を有する半導体レーザーと、ZnCdSe活性層の 上下をn型ZnMgSSe光導波層とp型ZnMgSS e光導波層とで挟み、さらにその上下をn型2nMgS Seクラッド層とp型ZnMgSSeクラッド層とで挟 んだSCH樽造(Separated ConfinementHeterostructu re)を有する半導体レーザーとについてしきい値電流密 度(J13)の活性層の厚さ依存性を計算により求めた結 果を図13に示す。ただし、DH構造を有する半導体レ 10 ーザーおよびSCH構造を有する半導体レーザーとも共 振器長Lは500μm、内部損失α:。は10cm-1とし た。また、DH構造を有する半導体レーザーについて は、ZnSe活性層とn型ZnMgSSeクラッド層お よびp型ZnMgSSeクラッド層との間の屈折率差Δ nが0.13である場合と0.2である場合との二通り について計算を行った。一方、SCH構造を有する半導 体レーザーについては、2nCdSe活性層とn型2n MgSSe光導波層およびp型ZnMgSSe光導波層 とn型ZnMgSSeクラッド層およびp型ZnMgS Seクラッド層との間の屈折率差Δn. は0. 2、n型 ZnMgSSe光導波層およびp型ZnMgSSe光導 波層のそれぞれの厚さW。は75nmとした。

【0007】図13からわかるように、DH構造を有す る半導体レーザーにおいては、活性層の厚さが30~4 0 nmのときにしきい値電流密度は極小値をとり、活性 層の厚さがこの極小値を与える厚さの近傍にあるとき、 すなわち活性層の厚さが15~60nmのときにはしき い値電流密度は十分に低くなる。一方、SCH構造を有 30 する半導体レーザーにおいては、活性層の厚さが約10 nmになるまでは、活性層の厚さの減少とともにしきい 値電流密度は減少し、活性層の厚さが2~20nmのと きにはしきい値電流密度は十分に低くなる。以上のこと から、レーザー構造を形成するための材料としてII-VI族化合物半導体を用いた場合、DH構造を有する半 導体レーザーにおいても、またSCH構造を有する半導 体レーザーにおいても、しきい値電流密度を低くするた めには、活性層の厚さを十分に小さくしてキャリアの注 入効率を高くすることの重要性を理解することができ

【0008】このように活性層の厚さを小さくしてキャ リアの注入効率を高くすることの重要性は、以下の実験 結果からも明らかである。すなわち、図14は2nSS e活性層の上下をn型ZnMgSSeクラッド層とp型 ZnMgSSeクラッド層とで挟んだDH構造を有する 半導体レーザーにおける厚さ70nmのZnSSe活性 層から得られたフォトルミネッセンス(PL)強度の減 衰曲線を示す。この図14に示す減衰曲線の傾きよりP

る。ZnSe結晶の発光再結合寿命は数nsecと予想 されるので、この約50psecという時定数での非常 に速いPL強度の減衰は非発光再結合過程に支配されて いると考えられる。しかしながら、同一の試料を用い て、光励起によりレーザー発振を実現することもでき る。これは、試料中の非発光中心の数がPL測定におけ る弱励起条件の励起光により励起されるキャリアの数と 同程度であるため、強励起条件の光励起時にはトラップ が飽和してレーザー発振が起こるのに十分なキャリアが **蓄積されるためであると説明される。このようなトラッ** プを含む結晶を用いて作製される半導体レーザーにおい ては、通常にも増して効率良くキャリアを活性層に注入 することが重要になってくる。この点からも、II-V I 族化合物半導体を用いた半導体レーザーのしきい値電 流密度を低くするためには、活性層の厚さを小さくする ことが有効であることがわかる。

【0009】さらに、本発明者の知見によれば、SCH 構造を有する半導体レーザーにおいて活性層を単一量子 井戸構造または二重量子井戸構造とした場合には、活性 との間の屈折率差 Δ n。は0. 1、2n Cd Se 活性層 20 層を三重量子井戸構造とした場合に比べて、しきい値電 流密度はほぼ半減する(ただし、量子井戸層の厚さは同 一とする)。従って、SCH構造を有する半導体レーザ 一のしきい値電流密度を低くするためには、活性層を単 一量子井戸構造または二重量子井戸構造とするのが有効 であることがわかる。

> 【0010】この発明は、本発明者の上記知見および検 討に基づき、さらに種々の検討を加えた結果案出された ものである。

【0011】すなわち、上記目的を達成するため、この 発明の第1の発明による半導体レーザーは、化合物半導 体基板(1)上に積層された第1導電型の第1のクラッ ド層(3)と、第1のクラッド層(3)上に積層された 第1の光導波層(4)と、第1の光導波層(4)上に積 層された活性層(5)と、活性層(5)上に積層された 第2の光導波層(6)と、第2の光導波層(6)上に積 層された第2導電型の第2のクラッド層(7)とを有 し、第1のクラッド層(3)、第1の光導波層(4)、 活性層(5)、第2の光導波層(6)および第2のクラ ッド層(7)はZn1-x-y Cdx Mg, S. Te。Se 40 1-1-6 (ただし、 $0 \le x < 1$ 、 $0 \le y < 1$ 、 $0 \le a <$ 1、0≤b<1) 系化合物半導体から成るとともに、活 性層(5)は単一の量子井戸層(5b)を有し、かつ量 子井戸層(5b)の厚さは2~20nmであることを特 徴とするものである。

【0012】この発明の第2の発明による半導体レーザ ーは、この発明の第1の発明による半導体レーザーにお いて、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層 (7) はZnMgSSe系化合物半導体から成り、第1 の光導波層(4)および第2の光導波層(6)は2nS L強度の減衰の時定数を求めると、約50psecとな 50 Se系化合物半導体またはZnSe系化合物半導体から

成り、活性層(5)は2nCdSe系化合物半導体から 成る量子井戸層から成ることを特徴とするものである。

【0013】この発明の第3の発明による半導体レーザ ーは、この発明の第1の発明による半導体レーザーにお いて、化合物半導体基板 (1) はG a A s 基板であり、 第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッファ層 (2) を介してGaAs基板上に積層され、第1のクラ ッド層(3) および第2のクラッド層(7) は0<p≤ 0. 2, $0 < q \le 0$. $3 O Z n_{1-p} M g_p S_q S e_{1-q}$ から成り、第1の光導波層(4)および第2の光導波層 10 (6) は0 < u ≤ 0. 1 の Z n S 。 S e 1 - a または Z n Seから成り、活性層 (5) は0 < z ≤ 0. 3の2n 1-1 Cd: Seから成る量子井戸層から成り、第1のク ラッド層(3)および第2のクラッド層(7)と最子井 戸層との間のパンドギャップの差は0.25eV以上で あり、第1の光導波層(4)および第2の光導波層 (6)と量子井戸層との間のパンドギャップの差は0. 1 e V以上であることを特徴とするものである。

【0014】この発明の第4の発明による半導体レーザ ーは、この発明の第1の発明による半導体レーザーにお 20 いて、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層 (7) はZnMgSSe系化合物半導体から成り、第1 の光導波層(4)および第2の光導波層(6)は2nM gSSe系化合物半導体から成り、活性層(5)は2n Se系化合物半導体またはZnSSe系化合物半導体か ら成る量子井戸層から成ることを特徴とするものであ る。

【0015】この発明の第5の発明による半導体レーザ ーは、この発明の第1の発明による半導体レーザーにお いて、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であり、 第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッファ層 (2) を介してGaAs基板上に積層され、第1のクラ ッド層(3) および第2のクラッド層(7) は0.1≤ $p \le 0.4, 0.15 \le q \le 0.450 Z n_{1-}, Mg_{p}$ S。Se1-。から成り、第1の光導波層(4)および第 2の光導波層(6)は0.05≦p≤0.15、0.1 $\leq q \leq 0$. 2のZn₁-, Mg, S, Se₁-。から成り、 活性層(5)はZnSeから成る量子井戸層から成り、 第1のクラッド層(3) および第2のクラッド層(7) と量子井戸層との間のバンドギャップの差は0.25e V以上であり、第1の光導波層(4)および第2の光導 波層(6)と量子井戸層との間のパンドギャップの差は 0. 1 e V以上であることを特徴とするものである。 【0016】この発明の第6の発明による半導体レーザ

ーは、この発明の第1の発明による半導体レーザーにお いて、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であり、 第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッファ層 (2)を介してGaAs基板上に積層され、第1のクラ ッド層(3)および第2のクラッド層(7)は0.15 $\leq p \leq 0.5, 0.2 \leq q \leq 0.5502 n_{1-p} Mg_{p}$

S、Se1-、から成り、第1の光導波層 (4) および第 2の光導波層(6)は0.1≤p≤0.2、0.15≤ q≦0. 25のZn₁-, Mg, S, Se₁-, から成り、 活性層(5)は0.01≦u≦0.1の2nS。Se :- 。から成る量子井戸層から成り、第1のクラッド層 (3) および第2のクラッド層(7) と量子井戸層との

10

間のパンドギャップの差は0.25e V以上であり、第 1の光導波層(4)および第2の光導波層(6)と量子 井戸層との間のパンドギャップの差は0.1eV以上で

あることを特徴とするものである。

【0017】この発明の第7の発明による半導体レーザ ーは、化合物半導体基板(1)上に積層された第1導電 型の第1のクラッド層(3)と、第1のクラッド層 (3) 上に積層された第1の光導波層(4)と、第1の 光導波層(4)上に積層された活性層(5)と、活性層 (5) 上に積層された第2の光導波層(6)と、第2の 光導波層(6)上に積層された第2導電型の第2のクラ ッド層(7)とを有し、第1のクラッド層(3)、第1 の光導波層(4)、活性層(5)、第2の光導波層 (6) および第2のクラッド層(7) は2n₁₋₁₋, Cd 1 Mg, S. Teb Se1-1-b (ただし、0≦x<1、 0 ≤ y < 1、0 ≤ a < 1、0 ≤ b < 1) 系化合物半導体 から成るとともに、活性層(5)は二つの量子井戸層 (5 a、5 c) を有し、かつ二つの量子井戸層 (5 a、 5 c) の合計の厚さは2~20 nmであることを特徴と するものである。

【0018】この発明の第8の発明による半導体レーザ ーは、この発明の第7の発明による半導体レーザーにお いて、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層 (7) は2nMgSSe系化合物半導体から成り、第1 の光導波層(4)および第2の光導波層(6)は2nS Se系化合物半導体またはZnSe系化合物半導体から 成り、活性層(5)はZnCdSe系化合物半導体から 成る第1の量子井戸層(5 a)、第1の量子井戸層(5 a) 上に積層されたZnSe系化合物半導体から成る障 壁層(5b)および障壁層(5b)上に積層されたZn CdSe系化合物半導体から成る第2の量子井戸層 (5 c)から成ることを特徴とするものである。

【0019】この発明の第9の発明による半導体レーザ 40 ーは、この発明の第7の発明による半導体レーザーにお いて、化合物半導体基板 (1) はG a A s 基板であり、 第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッファ層 (2)を介してGaAs基板上に積層され、第1のクラ ッド層(3)および第2のクラッド層(7)は0<p≤ 0. 2. $0 < q \le 0$. $302n_{1-p}$ Mg, S_q Se_{1-q} から成り、第1の光導波層(4)および第2の光導波層 (6) は0 < u ≤ 0. 1 の Z n S 。 S e 1 - u または Z n Seから成り、活性層(5)は0<z≤0.3のZn 1-1 Cd, Seから成る第1の量子井戸層 (5 a)、第 1の量子井戸層(5a)上に積層されたZnSeから成

50

る障壁層 (5 b) および障壁層 (5 b) 上に積層された $0 < z \le 0$. $3 \text{ o} \text{ Z} \text{ n}_{1-1}$ Cd. Seから成る第2の量子井戸層 (5 c) から成り、第1のクラッド層 (3) および第2のクラッド層 (7) と第1の量子井戸層 (5 a) および第2の量子井戸層 (5 c) との間のパンドギャップの差は0. 25 e V以上であり、第1の光導波層 (4) および第2の光導波層 (6) と第1の量子井戸層 (5 a) および第2の量子井戸層 (5 c) との間のパンドギャップの差は0. 1 e V以上であることを特徴とするものである。

【0021】この発明の第11の発明による半導体レー ザーは、この発明の第7の発明による半導体レーザーに おいて、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であ り、第1のクラッド層(3)はZnSeから成るパッフ ァ層(2)を介してGaAs基板上に積層され、第1の クラッド層(3) および第2のクラッド層(7)は0. g, S, Se1-。から成り、第1の光導波層(4)およ び第2の光導波層 (6) は0.05≤p≤0.15、 0. 1≤q≤0. 2のZn₁₋, Mg, S₄ Se₁₋₄ から 成り、活性層(5)は2nSeから成る第1の量子井戸 層(5a)、第1の量子井戸層(5a)上に積層された 0. $0.5 \le p \le 0.15$, 0. $1 \le q \le 0.20$ 1-, Mg, S,Se1-, から成る障壁層 (5b) および 障壁層 (5b) 上に積層された ZnSeから成る第2の 量子井戸層(5c)から成り、第1のクラッド層(3) および第2のクラッド層(7)と第1の量子井戸層(5 a) および第2の量子井戸層(5c) との間のパンドギ ャップの差は0.25e V以上であり、第1の光導波層 (4) および第2の光導波層(6) と第1の量子井戸層 (5 a) および第2の量子井戸層(5 c) との間のパン ドギャップの差は0.1eV以上であることを特徴とす るものである。

【0022】この発明の第12の発明による半導体レーザーは、この発明の第7の発明による半導体レーザーにおいて、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であり、第1のクラッド層(3)は7nSeから成るパッフ

ァ層(2)を介してG a A s 基板上に積層され、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層(7)は0. $15 \le p \le 0$. 5. 0. $2 \le q \le 0$. 55のZ n_{1-p} . Mg, S。Se₁₋。から成り、第1の光導波層(4)および第2の光導波層(6)は0. $1 \le p \le 0$. 2. 0. 15 $\le q \le 0$. 25のZ n_{1-p} Mg, S。Se₁₋。から成り、活性層(5)は0. 01 $\le u \le 0$. 10Z n5。Se₁₋。から成る第1の量子井戸層(5 a)、第1の量子井戸層(5 a)上に積層された0. $1 \le p \le 0$. 2.

12

10 0.15≤q≤0.25のZn1-, Mg, S。Se1-q から成る障壁層(5b)および障壁層(5b)上に積層 された0.01≤u≤0.1のZnS。Se1-。から成 る第2の量子井戸層(5c)から成り、第1のクラッド 層(3)および第2のクラッド層(7)と第1の量子井 戸層(5a)および第2の量子井戸層(5c)との間の バンドギャップの差は0.25eV以上であり、第1の 光導波層(4)および第2の光導波層(6)と第1の量 子井戸層(5a)および第2の光導波層(6)と第1の量 子井戸層(5a)および第2の量子井戸層(5c)との 間のバンドギャップの差は0.1eV以上であることを 20 特徴とするものである。

【0024】この発明の第14の発明による半導体レーザーは、この発明の第13の発明による半導体レーザーにおいて、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層(7)はZnMgSSe系化合物半導体から成り、活性層(5)はZnSSe系化合物半導体、ZnSe系化合物半導体またはZnCdSe系化合物半導体から成ることを特徴とするものである。

り、第1のクラッド層 (3) は2 n S e から成るパッフ 50 【0026】この発明の第16の発明による半導体レー

ザーは、この発明の第13の発明による半導体レーザー において、化合物半導体基板 (1) はGaAs基板であ り、第1のクラッド層(3)はZnSeから成るパッフ ァ層 (2) を介してGaAs基板上に積層され、第1の クラッド層(3)および第2のクラッド層(7)は0. $1.5 \le p \le 0.5$, $0.2 \le q \le 0.55 \mathcal{O} Z n_{1-p} M$ g。 S。 Se₁-。から成り、活性層(5)は0 <u≤ 0. 1の2nS。Sei-。から成り、第1のクラッド層 (3) および第2のクラッド層(7) と活性層(5) と の間のパンドギャップの差は 0.25 e V以上であるこ 10 とを特徴とするものである。

【0027】この発明の第17の発明による半導体レー ザーは、この発明の第13の発明による半導体レーザー において、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であ り、第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッフ ァ層 (2) を介してGaAs基板上に積層され、第1の クラッド層(3) および第2のクラッド層(7) は0く p≤0. 2, 0<q≤0. 3のZn_{1-p} Mg, S_q Se 1-c から成り、活性層 (5) は0 < z ≤ 0. 3の Z n び第2のクラッド層(7)と活性層(5)との間のパン ドギャップの差は0.25eV以上であることを特徴と するものである。

【0028】この発明の第18の発明による半導体レー ザーは、化合物半導体基板(1)上に積層された第1導 電型の第1のクラッド層(3)と、第1のクラッド層 (3) 上に積層された活性層(5)と、活性層(5)上 に積層された第2導電型の第2のクラッド層(7)とを 有し、第1のクラッド層(3)、活性層(5)および第 2のクラッド層 (?) はZni-i-, Cd, Mg, S, T 30 еь Se:-,-ь (ただし、0≤x<1、0≤y<1、0 ≤a<1、0≤b<1) 系化合物半導体から成るととも に、活性層(5)は複数の量子井戸層を有し、かつ複数 の量子井戸層の合計の厚さは10~35nmであること を特徴とするものである。

【0029】この発明の第19の発明による半導体レー ザーは、この発明の第18の発明による半導体レーザー において、第1のクラッド層(3)および第2のクラッ ド層(7)はZnMgSSe系化合物半導体から成り、 活性層(5)は交互に積層された乙nSSe系化合物半 40 導体またはZnMgSSe系化合物半導体から成る複数 の障壁層およびZnSe系化合物半導体から成る複数の 量子井戸層から成ることを特徴とするものである。

【0030】この発明の第20の発明による半導体レー ザーは、この発明の第18の発明による半導体レーザー において、化合物半導体基板(1)はGaAs基板であ り、第1のクラッド層(3)はZnSeから成るパッフ ァ層(2)を介してGaAs基板上に積層され、第1の クラッド層(3) および第2のクラッド層(7)は0. 1≤p≤0.4、0.15≤q≤0.45のZn_{1-p} M 50 CH構造を有する半導体レーザーを実現することができ

14

g, S。Se1-。から成り、活性層(5)は交互に積層 された0. $0.5 \le p \le 0.4$ 、0. $1 \le q \le 0.450$ Zni-, Mg, S。Sei-。から成る複数の障壁層およ び2nSeから成る複数の量子井戸層から成り、第1の クラッド層(3)および第2のクラッド層(7)と量子 井戸層との間のパンドギャップの差は0.25eV以上 であり、障壁層と量子井戸層との間のパンドギャップの 差は0.1eV以上であることを特徴とするものであ

【0031】この発明の第21の発明による半導体レー ザーは、この発明の第18の発明による半導体レーザー において、化合物半導体基板 (1) はG a A s 基板であ り、第1のクラッド層(3)は2nSeから成るパッフ ァ層(2)を介してGaAs基板上に積層され、第1の クラッド層(3) および第2のクラッド層(7)は0. $1.5 \le p \le 0$, 5, 0, $2 \le q \le 0$, $5.5 \circ Z n_{1-p} M$ g, S, Se1-, から成り、活性層(5)は交互に積層 Zni-, Mg, S, Sei-, から成る複数の障壁層およ 1-1 Cd. Seから成り、第1のクラッド層 (3) およ 20 び0 < u ≤ 0. 1の 2 n Su Se 1-1 から成る複数の量 子井戸層から成り、第1のクラッド層(3)および第2 のクラッド層(7)と量子井戸層との間のパンドギャッ プの差は0.25eV以上であり、障壁層と量子井戸層 との間のパンドギャップの差は0.1e V以上であるこ とを特徴とするものである。

[0032]

【作用】第1の発明による半導体レーザーによれば、第 1のクラッド層(3)および第2のクラッド層(7)を Zni-i-, Cdi Mg, S. Te, Sei-i-, 系化合物 半導体においてx=0、b=0としたもの、すなわち2 nMgSSe系化合物半導体で形成することにより、2 nMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として 用いた、青色ないし緑色で発光が可能なSCH構造を有 する半導体レーザーを実現することができる。しかも、 活性層(5)は単一の量子井戸層(5b)を有し、かつ 量子井戸層 (5b) の厚さは2~20nmであることに より、この半導体レーザーは低しきい値電流である。

【0033】第2の発明~第6の発明による半導体レー ザーによれば、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッ ド層の材料として用いた、緑色で発光が可能でしかも低 しきい値電流のSCH構造を有する半導体レーザーを実 現することができる。

【0034】第7の発明による半導体レーザーによれ ば、第1のクラッド層(3)および第2のクラッド層 (7) &Zn1-1-, Cd1 Mg, S. Teb Se1-1-b 系化合物半導体においてx=0、b=0としたもの、す なわちZnMgSSe系化合物半導体により形成するこ とにより、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層 の材料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能なS

る。しかも、活性層 (5) は二つの量子井戸層 (5b、5d) を有し、かつ二つの量子井戸層 (5b、5d) の合計の厚さは $2\sim20$ nmであることにより、この半導体レーザーは低しきい値電流である。

【0035】第8の発明~第12の発明による半導体レーザーによれば、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いた、緑色で発光が可能でしかも低しきい値電流のSCH構造を有する半導体レーザーを実現することができる。

【0036】第13の発明による半導体レーザーによれ 10 は、第1のクラッド層 (3) および第2のクラッド層 (7) を $2n_{1-1-}$, Cd_1 Mg, S_1 Te, Se_{1-1-} , 系化合物半導体においてx=0, b=0としたもの、すなわち2n Mg SS e 系化合物半導体で形成することにより、2n Mg SS e 系化合物半導体をクラッド層の材料として用いた、青色なしい緑色で発光が可能なDH構造を有する半導体レーザーを実現することができる。しかも、活性層 (5) の厚さは $15\sim60$ nmであることにより、この半導体レーザーは低しきい値電流である。

【0037】第14の発明〜第17の発明による半導体 20 レーザーによれば、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能でしかも低しきい値電流のDH構造を有する半導体レーザーを実現することができる。

【0038】第18の発明による半導体レーザーによれば、第1のクラッド層(3) および第2のクラッド層(7)を2n_{1-x-}、Cd_x Mg, S_x Te_x Se_{1-x-}、系化合物半導体においてx=0、b=0としたもの、すなわち Zn Mg S S e 系化合物半導体で形成することにより、Zn Mg S S e 系化合物半導体をクラッド層の材 30料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能なDH構造を有する半導体レーザーを実現することができる。しかも、活性層(5)は複数の量子井戸層を有し、かつ複数の量子井戸層の合計の厚さは10~35nmであることにより、この半導体レーザーは低しきい値電流である。

【0039】第19の発明〜第21の発明による半導体レーザーによれば、ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料として用いた、青色ないし緑色で発光が可能でしかも低しきい値電流のDH構造を有する半導体 40レーザーを実現することができる。

[0040]

【実施例】以下、この発明の実施例について図面を参照 しながら説明する。なお、実施例の全図において、同一 または対応する部分には同一の符号を付す。

【0041】図1はこの発明の第1実施例による半導体レーザーを示す。この第1実施例による半導体レーザーはSCH構造を有するものである。

【0042】図1に示すように、この第1実施例による 0.07、q=0.14、z=0.14のときのこれら 半導体レーザーにおいては、例えばn型不純物としてS 50 の層のパンドギャップ E_z の値とともに図2に示す。な

iがドープされた(100)面方位のn型GaAs基板 1上に、例えばn型不純物としてClがドープされたn型ZnSeパッファ層2、例えばn型不純物としてClがドープされたn型Zni-。Mg。S。Sei-。クラッド層3、例えばn型不純物としてClがドープされたn型ZnSe光導波層4、活性層5、例えばp型不純物と

16

してNがドープされたp型ZnSe光導波層6、例えば p型不純物としてNがドープされたp型Zni-, Mg, S、Sei-。クラッド層7および例えばp型不純物とし てNがドープされたp型ZnSeキャップ層8が順次積

てNがドープされたp型ZnSeキャップ層8が順次積 層されている。

【0043】さらに、p型ZnSeキャップ層8上には、ストライプ状の開口9aを有する例えばポリイミド、SiO、膜、SiN、膜などから成る絶縁層9が形成されている。そして、この開口9aを通じてp型ZnSeキャップ層8に例えばAu/Pd電極やAu電極のようなp側電極10がコンタクトしている。一方、n型GaAs基板1の裏面には、例えばIn電極のようなn側電極11がコンタクトしている。

【0044】この第1実施例においては、活性層5は例えば厚さが6nmのi型Zni-, Cd, Se量子井戸層から成る単一量子井戸構造を有する。この場合、n型ZnSe光導波層4およびp型ZnSe光導波層6が障壁層を構成する。

【0045】n型Zn₁-, Mg, S, Se₁-, クラッド 層3およびp型Zni-, Mg, S,Sei-, クラッド層 7のMg組成比pは例えば0.07、またS組成比gは 例えば0. 14であり、そのときのバンドギャップE。 は約2.87eVである。これらのMg組成比p=0. 07およびS組成比q=0.14を有するn型Zn1-p Mg, S, Se₁-。クラッド層3およびp型2n₁₋, M g, S。Sei-。クラッド層7はGaAsと格子整合す る。また、n型ZnSe光導波層4およびp型ZnSe 光導波層6のパンドギャップE。は約2.72eVであ る。さらに、活性層 5 を構成する i 型 Z n1-, Cd. S e量子井戸層のCd組成比zは例えば0.14であり、 そのときのパンドギャップE。は約2、54eVであ る。この場合、n型Zn₁-。Mg。S。Se₁-。クラッ ド層3およびp型Zni-。Mg。S。Sei-。クラッド 層7と活性層5を構成するi型Zni-, Cd. Se量子 井戸層との間のパンドギャップE。の差ΔE。は0.3 3eVであり、n型ZnSe光導波層4およびp型Zn Se光導波層6と活性層5を構成する1型2 n:-: Cd : Se量子井戸層との間のパンドギャップE。の差△E 。は0.18eVである。n型Zn1-, Mg, S。Se 1-。 クラッド層3、n型2nSe光導波層4、活性層 5、p型ZnSe光導波層6およびp型Zn₁-。Mg。 Sc Sei-。クラッド層7のエネルギーパンド図をp= 0. 07、q=0. 14、z=0. 14のときのこれら

お、図2において、E、は伝導帯の下端のエネルギーで ある(以下同様)。

【0046】n型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッド 層3およびp型2ni-。Mg。S。Sei-。 クラッド層 7の厚さは好適にはそれぞれ0.5μm以上に選ばれ、 具体的にはn型Zn1-。Mg。S。Se1-。クラッド層 3の厚さは例えば1μm、p型Zn1-, Mg, S, Se 1-。 クラッド層7の厚さは例えば0. 6μmに選ばれ る。また、n型ZnSe光導波層4およびp型ZnSe 光導波層 6 の厚さは好適にはそれぞれ 2 0~1 0 0 nm 10 の範囲に選ばれ、具体的には例えばそれぞれ50nmに 選ばれる。さらに、p型ZnSeキャップ層8の厚さは 好適には0.5 um以上に選ばれる。

【0047】また、n型2nSeパッファ層2の厚さ は、ZnSeとGaAsとの間にはわずかではあるが格 子不整合が存在することから、この格子不整合に起因し てこのn型2nSeパッファ層2及びその上の各層のエ ピタキシャル成長時に転位が発生するのを防止するため に、ZnSeの臨界膜厚(~100nm)よりも十分に 小さく選ばれ、具体的には例えば2 nmに選ばれる。

【0048】次に、上述のように構成されたこの第1実 施例による半導体レーザーの製造方法について説明す

【0049】この第1実施例による半導体レーザーを製 造するには、まず、n型GaAs基板1上に、例えば分 子線エピタキシー(MBE)法により、n型ZnSeバ ッファ層2、n型2n:-, Mg, S, Se:-, クラッド 層3、n型ZnSe光導波層4、i型Zni-, Cd, S e量子井戸層から成る活性層 5、p型2nSe光導波層 びp型2nSeキャップ層8を順次エピタキシャル成長 させる。

【0050】上述のMBE法によるエピタキシャル成長 においては、例えば、2n原料としては純度99.99 99%のZnを用い、Mg原料としては純度99.9% のMgを用い、S原料としては99. 9999%のZn Sを用い、Se原料としては純度99. 9999%のS eを用いる。また、n型ZnSeパッファ層2、n型Z ni-, Mg, S, Sei-, クラッド層3およびn型Zn は例えば純度99.9999%の2nCl2をドーパン トとして用いて行い、p型ZnSe光導波層6、p型Z ni-, Mg, S。Sei-。クラッド層7およびp型Zn Seキャップ層8のp型不純物としてのNのドーピング は例えば電子サイクロトロン共鳴(ECR)により発生 されたN2 プラズマを照射することにより行う。

【0051】次に、p型2nSeキャップ層8の全面に 絶縁層9を形成した後、この絶縁層9の所定部分を除去 して開口9aを形成する。次に、全面にAu/Pd膜や 18

なp側電極10を形成し、その後必要に応じて熱処理を 行って、このp側電極10をp型ZnSeキャップ層8 にオーミックコンタクトさせる。一方、n型GaAs基 板1の裏面にはIn電極のようなn側電極11を形成す

【0052】この後、以上のようにしてレーザー構造が 形成された n型GaAs基板1を例えばパー状に劈開し て共振器端面を形成し、このパーを劈開してチップ化 し、パッケージングを行う。

【0053】この第1実施例による半導体レーザーの光 出力-電流特性の測定結果を図3に示す。この測定に用 いた半導体レーザーの単一量子井戸(SQW)構造の活 性層 5 を構成する 1 型 2 n i - 。 C d 。 S e 量子井戸層の 厚さは6 nmである。図3には、比較のために、活性層 が厚さ6nmのi型2ni-, Cd, Se量子井戸層と厚 さ4nmのi型ZnSe障壁層とを交互に積層した三重 量子井戸(TQW)構造となっていることを除いてこの 第1実施例による半導体レーザーと同様な構造を有する 半導体レーザーの光出力ー電流特性の測定結果も示して 20 ある。後者の場合には、活性層における三つの量子井戸 層の合計の厚さは6nm×3=18nmである。

【0054】図3より明らかなように、単一量子井戸構 造の活性層5を構成する量子井戸層の厚さが6nmであ るときのこの第1実施例による半導体レーザーのしきい 値電流は、三重量子井戸構造の活性層における三つの量 子井戸層の合計の厚さが18ヵmである半導体レーザー のしきい値電流と比較して、ほぼ1/2に低減されてい

【0055】また、この第1実施例による半導体レーザ 6、p型Zn1-, Mg, S。Se1-。クラッド層7およ 30 一の発振波長を測定したところ、室温において約498 nmであった。

【0056】以上のように、この第1実施例によれば、 n型Zni-, Mg, S, Sei-, クラッド層3、n型Z nSe光導波層4、単一量子井戸構造の活性層5、p型 ZnSe光導波層6およびp型Zni-, Mg, S。Se 1-。 クラッド層 7 によりレーザー構造を形成し、しかも 活性層5を構成するi型2nュ-,Cd,Se量子井戸層 の厚さを例えば6 nmと小さく選んでいることにより、 ZnMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料とし Se光導波層4のn型不純物としてのC1のドーピング 40 て用いた、室温において波長約498nmで発振可能な 緑色発光でしかも低しきい値電流密度のSCH構造を有 する半導体レーザーを実現することができる。また、こ の半導体レーザーは、低しきい値電流密度であることに より発熱を抑えることができ、寿命特性の向上を図るこ とができる。さらに、この半導体レーザーは低しきい値 電流であることにより低消費電力である。

> 【0057】次に、この発明の第2実施例による半導体 レーザーについて説明する。

【0058】この第2実施例による半導体レーザーは、 Au膜を真空蒸着してAu/Pd電極やAu電極のよう 50 括性層 5 が図 4 に示すように二重量子井戸構造を有する

ことを除いて、第1実施例による半導体レーザーと同様 な構造を有する。図4に示すように、この第2実施例に よる半導体レーザーにおいては、活性層5は、1型Zn 1-1 Cd, Se量子井戸層5a、1型ZnSe障壁層5 bおよびi型Zni-, Cd, Se量子井戸層5cが順次 積層された二重量子井戸構造を有する。ここで、i型Z ni-: Cd, Se量子井戸層5aおよびi型Zni-, C d. Se量子井戸層5cの厚さはそれぞれ例えば6nm であり、i型ZnSe障壁層5bの厚さは例えば4nm である。この場合、活性層5における二つのi型Zn 1-1 Cd: Se量子井戸層5aおよび1型Zn:-, Cd Se量子井戸層5cの合計の厚さは6nm×2=12 nmである。この活性層5のエネルギーバンド図を図5

【0059】この第2実施例による半導体レーザーの製 造方法は、第1実施例による半導体レーザーの製造方法 と同様であるので説明を省略する。

【0060】この第2実施例によっても、第1実施例に よる半導体レーザーと同様に、ZnMgSSe系化合物 緑色発光が可能でしかも低しきい値電流密度のSCH構 造を有する半導体レーザーを実現することができる。

【0061】次に、この発明の第3実施例による半導体 レーザーについて説明する。

【0062】図6はこの第3実施例による半導体レーザ ーを示す。この第3実施例による半導体レーザーはDH 構造を有するものである。

【0063】図6に示すように、この第3実施例による 半導体レーザーにおいては、例えばn型不純物としてS 1上に、例えば n型不純物として C 1 がドープされた n 型2nSeバッファ層2、例えばn型不純物としてC1 がドープされたn型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッ ド層3、活性層5、例えばp型不純物としてNがドープ されたp型Zni-, Mg, S。Sei-。クラッド層7お よび例えばp型不純物としてNがドープされたp型Zn Seキャップ層8が順次積層されている。

【0064】p型2nSeキャップ層8上に絶縁層9が 形成され、この絶縁層9に形成されたストライプ状の開 口9aを通じてp型ZnSeキャップ層8にp側電極1 0がコンタクトしていることやn型GaAs基板1の裏 面にn側電極11がコンタクトしていることは、第1実 施例による半導体レーザーと同様である。

【0065】この場合、活性層5は、単層の2nSe 層、ZnSu Sei-u 層またはZni-, Cd. Se層に より形成される。また、この活性層5の厚さは15~6 0 nmの範囲に選ばれ、好ましくは20~40 nmの範 囲に選ばれる。

【0066】活性層5を2nSe層により形成する場

20

びp型Zni-, Mg, S, Sei-, クラッド層7のMg 組成比pは例えば0.23、またS組成比gは例えば 0. 28である。このときの活性層5のパンドギャップ E, は約2. 72eV、n型Zni-, Mg, S, Se 1-gクラッド層3およびp型Zn1-p Mgp Sc Se 1-q クラッド層7のパンドギャップE。は約3.05e Vである。この場合、n型Zn:-, Mg, S。Se:-。 クラッド層3およびp型2n₁-。Mg。S。Se₁-。ク ラッド層7と活性層5との間のパンドギャップE。の差 10 ΔE, は0.33eVである。

【0067】また、活性層5をu=0.06のZnS。 Sei- N層により形成する場合、n型2ni- NMg S 。Sei-。クラッド層3およびp型Zni-。Mg。S。 Se1-。 クラッド層7のMg組成比pは例えば0. 2 6、またS組成比gは例えば0.31である。このとき の活性層5のパンドギャップE。は約2.76eV、n 型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッド層3およびp型 Zn:-, Mg, S, Sei-, クラッド層7のパンドギャ ップE, は約3.10eVである。この場合、n型Zn 半導体をクラッド層の材料として用いた、室温において 20 1-, Mg, S、Se1-。クラッド層 3 および p 型 2 n1-p Mg, S, Se1-。クラッド層7と活性層5との間 のバンドギャップE 。の差ΔE 。は0.34eVであ

【0068】さらに、活性層5をz=0.14の2n 1-, Cd, Se層により形成する場合、n型Zn₁₋, M g, S, Se₁₋₀ クラッド層3およびp型2n₁₋₉ Mg 。S。Seː-。 クラッド層7のMg組成比pは例えば 0、07、またS組成比qは例えば0、14である。こ のときの活性層5のパンドギャップE。は約2.54e iがドープされた(100)面方位のn型GaAs基板 30 V、n型Zni-, Mg, S。Sei-。クラッド層3およ びp型2ni-。Mg。SqSei-q クラッド層7のパン ドギャップE』は約2.87eVである。この場合、n 型Zn1-, Mg, S。Se1-。クラッド層3およびp型 Zni-, Mg, SqSei-q クラッド層7と活性層5と の間のパンドギャップ E_ϵ の差 ΔE_ϵ は0.33 eVで

> 【0069】n型2nSeパッファ層2、n型2n_{1-p} Mg, S, Se₁₋, クラッド層3、活性層5、p型Zn 1-p Mg, Sq Se1-q クラッド層7およびp型ZnS eキャップ層8の厚さは第1実施例による半導体レーザ ーと同様の値に選ぶことができる。

【0070】この第3実施例による半導体レーザーの製 造方法は、第1実施例による半導体レーザーの製造方法 と同様であるので説明を省略する。

【0071】この第3実施例によれば、単層のZnSe 層、ZnS。Sei-。層またはZni-, Cd. Se層に より形成される活性層5の厚さが15~60mmと十分 に小さく選ばれていることにより、第1実施例による半 導体レーザーと同様に、ZnMgSSe系化合物半導体 合、n型2n:-, Mg, S。Se:-。クラッド層3およ 50 をクラッド層の材料として用いた、室温において青色な

いし緑色で発光が可能な低しきい値電流密度のDH構造 を有する半導体レーザーを実現することができる。

【0072】次に、この発明の第4実施例による半導体 レーザーについて説明する。

【0073】この第4実施例による半導体レーザーにお いては、活性層 5 が Z n1-, Mg, S: S e1-1 から成 る複数の障壁層とZnSeまたはZnS。Se1-。から 成る複数の量子井戸層とを交互に積層した多重量子井戸 (MQW) 構造を有することを除いて、第3実施例によ る半導体レーザーと同様な構造を有する。この場合、こ 10 レーザーについて説明する。 の活性層 5 における複数の量子井戸層の合計の厚さは1 0~35nmの範囲に選ばれる。

【0074】活性層5における障壁層を2n1-1 Mg. Si Sei-i により形成し、量子井戸層をZnSeによ り形成する場合、障壁層を形成するZn:-, Mg, S: Sei-iのMg組成比sおよびS組成比tは例えばそれ ぞれ0. 1および0. 16に選ばれるか、例えばそれぞ れ0.23および0.28に選ばれる。また、この場合 のn型2ni-, Mg, S, Sei-, クラッド層3および p型Zn₁-, Mg, S₀ Se₁-, クラッド層7のMg組 20 成比pおよびS組成比gは例えばそれぞれ0.23およ び0.28に選ばれる。このときの活性層5における2 nSe量子井戸層のパンドギャップE。は約2.72e V、n型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッド層3およ びp型Zni-p Mg, S, Sei-, クラッド層7のパン ドギャップE。は約3.05eVである。この場合、n 型Zni-, Mg, S。Sei-。クラッド層3およびp型 Zni-, Mg, S, Sei-, クラッド層7と活性層5に おけるZnSe量子井戸層との間のバンドギャップE。 の差ΔE₂ は0.33eVである。

【0075】また、活性層5における障壁層を2n1-, Mg, S₁ Se₁₋₁ により形成し、量子井戸層を2nS u Se1-u により形成する場合、障壁層を形成するZn 1-. Mg. S. Sei-, のMg組成比sおよびS組成比 t は例えばそれぞれ0.13および0.19に選ばれる か、例えばそれぞれ0.26および0.31に選ばれ る。また、この場合のn型Zni-, Mg, S。Sei-。 クラッド層3およびp型2ni-, Mg, S。Sei-。ク ラッド層7のMg組成比pおよびS組成比qは例えばそ れぞれ0.26および0.31に選ばれる。このときの 40 活性層 5 における Z n S 、 S e 1-1 量子井戸層のバンド ギャップE。は約2.76eV、n型Zni-, Mg, S 。Sei-。クラッド層3およびp型Zni-,Mg, S。 S e1-a クラッド層7のバンドギャップEg は約3.1 0 e Vである。この場合、n型2n1-, Mg, S。Se I-a クラッド層3およびp型ZnI-, Mg, Sa Se 1-。クラッド層7と活性層5における2nS, Se1-1 量子井戸層との間のパンドギャップE。の差ΔE。は 0. 34eVである。

【0076】この第4実施例による半導体レーザーの製 50 なわち、図8はこの第5実施例による半導体レーザーの

22

造方法は、第1実施例による半導体レーザーの製造方法 と同様であるので説明を省略する。

【0077】この第4実施例によっても、第1実施例に よる半導体レーザーと同様に、ZnMgSSe系化合物 半導体をクラッド層の材料として用いた、室温において 青色ないし緑色で発光が可能な低しきい値電流密度のD H構造を有する半導体レーザーを実現することができ

【0078】次に、この発明の第5実施例による半導体

【0079】図7に示すように、この第5実施例による 半導体レーザーにおいては、例えばn型不純物としてS iがドープされた(100)面方位のn型GaAs基板 1上に、例えばn型不純物としてClがドープされたn 型2nSeパッファ層2、例えばn型不純物としてC1 がドープされたn型Zni-, Mg, S。Sei-。クラッ ド層3、例えばn型不純物としてC1がドープされたn 型2nSe光導波層4、活性層5、例えばp型不純物と してNがドープされたp型ZnSe光導波層6、例えば p型不純物としてNがドープされたp型2n1-, Mg, S、Sei-。クラッド層7、例えばp型不純物としてN がドープされたp型ZnS、Sei-、層12および例え ばp型不純物としてNがドープされたp型ZnSeキャ ップ層8が順次積層されている。ここで、p型ZnS。 Sei-v 層12は、p型Zni-,Mg, S, Sei-,ク ラッド層7と格子整合をとるための層として用いられる とともに、補助的なp型クラッド層として用いられる。 p型Zn₁-, Mg, S, Se₁-, クラッド層7との格子 整合をとるために、このp型ZnS、Se1-、層12の 30 S組成比vは好適には0.06に選ばれる。

【0080】この場合、p型ZnSeキャップ層8およ びp型2nS、Sei-、層12の上層部はストライプ形 状にパターニングされている。このストライプ部の幅は 例えば5 μmである。

【0081】さらに、上述のストライプ部以外の部分の p型2nS, Se1-, 層12上には、例えば厚さが30 0 n m のアルミナ (A 12 O3) 膜から成る絶縁層 9 が 形成されている。そして、ストライプ形状のp型ZnS eキャップ層8および絶縁層9上にp側電極10が形成 されている。このp側電極10がp型ZnSeキャップ 層8とコンタクトした部分が電流の通路となる。ここ で、このp側電極10としては、例えば、厚さが10n mのPd膜と厚さが100nmのPt膜と厚さが300 nmのAu膜とを順次積層したAu/Pt/Pd電極が 用いられる。一方、n型GaAs基板1の裏面には、例 えば I n電極のようなn側電極11がコンタクトしてい

【0082】この第5実施例による半導体レーザーにお いては、いわゆる端面コーティングが施されている。す

共振器長方向に垂直な一対の共振器端面のうちレーザー

8×10¹⁷ cm⁻³である。なお、n型2nSeパッファ 層2の厚さは、例えば33nmである。 【0086】この第5実施例による半導体レーザーの共 振器長しは例えば640μmに選ばれ、この共振器長方

24

光が取り出されるフロント側の端面には厚さ74nmの Al₂ O₃ 膜13と厚さ31nmのSi膜14とから成 る多層膜がコーティングされ、共振器長方向に垂直な一 対の共振器端面のうちレーザー光が取り出されないリア 側の端面には厚さ74nmのA 12 O3 膜13と厚さ3 1 nmのSi膜14とを2周期積層した多層膜がコーテ る。 ィングされている。ここで、Al2 Os膜13とSl膜 14とから成る多層膜の厚さは、それに屈折率をかけた 10 造するには、まず、n型GaAs基板1上に、例えばM 光学的距離が、レーザー光の発振波長の1/4に等しく

向に垂直な方向の幅は例えば400μmに選ばれる。 【0087】次に、上述のように構成されたこの第5実 施例による半導体レーザーの製造方法について説明す

【0083】この第5実施例においては、活性層5は例 えば厚さが9nmのi型Zni-, Cd, Se量子井戸層 から成る単一量子井戸構造を有する。この場合、n型2 nSe光導波層4およびp型ZnSe光導波層6が障壁 層を構成することは第1実施例と同様である。

なるように選ばれている。この場合、フロント側の端面

の反射率は70%であり、リア側の端面の反射率は95

%である。

【0088】この第5実施例による半導体レーザーを製 BE法により例えば成長温度280℃で、n型2nSe パッファ層2、n型2ni-, Mg, S。Sei-。クラッ ド層3、n型ZnSe光導波層4、1型Zni- Cd, Se量子井戸層から成る活性層5、p型ZnSe光導波 層6、p型2ni-p Mg, S, Sei-, クラッド層7、 p型2nS、Sei--層12およびp型2nSeキャッ プ層8を順次エピタキシャル成長させる。

【0084】n型Zn1-, Mg, S, Se1-, クラッド 層3およびp型Zn1-, Mg, S,Se1-, クラッド層 7のMg組成比pは例えば0.09、またS組成比qは 例えば0. 18であり、そのときのバンドギャップE。 は77Kで約2.94eVである。これらのMg組成比 p=0.09およびS組成比q=0.18を有するn型 Zni-, Mg, S, Sei-, クラッド層3およびp型Z ni-, Mg, S, Sei-, クラッド層7はGaAsと格 子整合する。また、活性層 5 を構成する i 型 2 ni-, C d. Se量子井戸層のCd組成比zは例えば0.19で あり、そのときのパンドギャップE。は77Kで約2. 54eVである。この場合、n型2n₁-。Mg。S。S e1-a クラッド層3およびp型Zn1-p Mgp Sc Se 1-c クラッド層7と活性層5を構成する1型2n1-1 C d: Se量子井戸層との間のパンドギャップE。の差 Δ E. は0.40eVである。

【0089】上述のMBE法によるエピタキシャル成長 においては、第1実施例と同様に、2n原料としては純 20 度99.9999%の2nを用い、Mg原料としては純 度99.9%のMgを用い、S原料としては99.99 99%の2nSを用い、Se原料としては純度99.9 999%のSeを用いる。また、n型ZnSeパッファ 層2、n型Zn_{1-p} Mg_p S_c Se_{1-c} クラッド層3お よびn型ZnSe光導波層4のn型不純物としてのC1 のドーピングは例えば純度99、9999%の2nC1 2 をドーパントとして用いて行う。第1実施例と同様 に、p型ZnSe光導波層6、p型Zni-p Mgp Sc Sei-a クラッド層7およびp型ZnSeキャップ層8 30 のp型不純物としてのNのドーピングは、ECRにより 発生されたN2プラズマを照射することにより行う。

【0085】この場合、n型Zni-, Mg, S, Se ι- 。 クラッド層 3 の厚さは例えば 1. 5 μmであり、不 純物濃度はN₀ - N_A (ただし、N₀ はドナー濃度、N л はアクセプタ濃度) で例えば5×10¹⁷ c m⁻³であ あり、不純物濃度はN₀ - N_k で例えば5×10¹⁷ c m - *である。また、p型2nSe光導波層6の厚さは例え ぱ80nmであり、不純物濃度はNx -No で例えば5 ×10¹⁷ cm⁻³である。p型Zn₁-, Mg, S, Se 1-。 クラッド層7の厚さは例えば0. 8μmであり、不 純物濃度はN_k - N_oで例えば2×10¹⁷ c m⁻³であ る。p型ZnS、Sei-、層12の厚さは例えば0.8 μ mであり、不純物濃度は N_{\star} $-N_{o}$ で例えば 8×10 17 cm-1である。p型ZnSeキャップ層8の厚さは例 えば $45\,\mathrm{nm}$ であり、不純物濃度は N_{\imath} $-\mathrm{N}_{\imath}$ で例えば 50 行って、この p 側電極 $10\,\mathrm{e}$ p 型 $2\,\mathrm{n}$ S e キャップ層8

【0090】次に、p型2nSeキャップ層8上に所定 幅のストライプ形状のレジストパターン(図示せず)を 形成した後、このレジストパターンをマスクとしてp型 2 n S v S e 1-v 層12の厚さ方向の途中までウエット エッチング法によりエッチングする。これによって、p 型ZnSeキャップ層8およびp型ZnS、Sei-・層 12の上層部がストライプ状にパターニングされる。

【0091】次に、上述のエッチングに用いたレジスト る。n型2nSe光導波層4の厚さは例えば80nmで 40 パターンを残したまま全面にAl2O3 膜を真空蒸着し た後、このレジストパターンを、その上に形成されたA 1209 膜とともに除去する (リフトオフ)。これによ って、ストライプ部以外の部分のp型ZnS, Sei-v 層12上にのみA12 O3 膜から成る絶縁層9が形成さ れる。

> 【0092】次に、ストライプ形状のp型ZnSeキャ ップ層8および絶縁層9の全面にPd膜、Pt膜および Au膜を順次真空蒸着してAu/Pt/Pd電極から成 る p 側電極 1 0 を形成し、その後必要に応じて熱処理を

にオーミックコンタクトさせる。一方、n型GaAs基 板1の裏面には1n電極のようなn側電極11を形成す る。

【0093】この後、以上のようにしてレーザー構造が 形成されたn型GaAs基板1を例えば幅640μmの パー状に劈開して両共振器端面を形成した後、真空蒸着 法により、フロント側の端面にAl2 O3 膜13とSi 膜14とから成る多層膜を形成するとともに、リア側の 端面にA12 Os 膜13とS1膜14とを2周期繰り返 した多層膜を形成する。このように端面コーティングを 10 施した後、このバーを例えば幅400μmに劈開してチ ップ化し、パッケージングを行う。

【0094】この第5実施例による半導体レーザーの室 温(296K)における光出力-電流特性を注入電流を 連続的に流した場合とパルス的に流した場合とについて 測定した結果を図9に示す。測定は、レーザーチップを 例えば銅製のヒートシンク上に、p側電極10が下側に なるように、すなわちpサイド・ダウンでマウントして 行った。図9からわかるように、注入電流を連続的に流 した場合のしきい値電流 Inは約45mAであり、これ 20 は約1.5kA/cm²のしきい値電流密度J:1kに対応 する。一方、注入電流をパルス的に流した場合のしきい 値電流 I ia は約42 mAである。ここで、注入電流を連 続的に流した場合の光出力ー電流特性の測定は、注入電 流を500mA/秒の速さで0から100mAに増加さ せて行った。一方、注入電流をパルス的に流した場合の 光出カー電流特性の測定は、注入電流のパルス幅 2 μ s、繰り返し速度1msで行った。図9からわかるよう に、注入電流をパルス的に流した場合および連続的に流 および0.31W/Aである。レーザー発振のしきい値 におけるp側電極10およびn側電極11間の印加電圧 は約17 Vである。

【0095】図10はこの第5実施例による半導体レー ザーを室温 (296K) で発振させたときの発光スペク トルの測定結果を示す。図10からわかるように、パル ス動作させた場合および連続動作させた場合においてそ れぞれ521.6 nmおよび523.5 nmの波長で誘 導放出が観測される。

【0096】以上のことからわかるように、この第5実 40 る。 施例によれば、室温において波長523.5nmで連続 発振可能な緑色発光でしかも低しきい値電流密度のSC H構造を有する半導体レーザーを実現することができ る。

【0097】以上、この発明の実施例について具体的に 説明したが、この発明は、上述の実施例に限定されるも のではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形 が可能である。

【0098】例えば、上述の第1実施例、第2実施例お よび第5実施例において用いられているn型2nSe光 50 おいては、化合物半導体基板としてGaAs基板を用い

26

導波層4およびp型ZnSe光導波層6の代わりにi型 ZnSe光導波層を用いてもよい。

【0099】また、上述の第1実施例においては、活性 層5は1型2n1-, Cd: Se量子井戸層だけにより構 成されているが、この活性層5は、場合によっては、図 11に示すように、i型2nSe障壁層5b、i型Zn 1-, Cd. Se量子井戸層5aおよびi型2nSe障壁 層5dを順次積層した単一量子井戸構造としてもよい。 ここで、i型2nt-、Cd、Se量子井戸層5aの厚さ は例えば6nmであり、i型ZnSe障壁層5bおよび i型ZnSe障壁層5dの厚さは例えばそれぞれ4nm

【0100】同様に、上述の第2実施例における活性層 5は、場合によっては、図12に示すように、1型2n Se障壁層5b、i型Zn:-, Cd, Se量子井戸層5 a、i型ZnSe障壁層5d、i型Zn:-, Cd. Se 量子井戸層5cおよび1型ZnSe障壁層5eを順次積 層した二重量子井戸構造としてもよい。ここで、1型2 ni-: Cd: Se量子井戸層5aおよびi型Zni-: C d. Se量子井戸層5cの厚さはそれぞれ例えば6nm であり、1型ZnSe障壁層5b、1型ZnSe障壁層 5 dおよび1型2nSe障壁層5eの厚さは例えばそれ ぞれ4nmである。

【0101】また、上述の第1実施例~第5実施例にお いて、p型ZnSeキャップ層8上にこのp型ZnSe キャップ層8よりも高不純物濃度のものが容易に得られ るp型ZnTeキャップ層を形成し、このp型ZnTe キャップ層にp側電極10をコンタクトさせるようにし てもよい。さらに、このp型ZnTeキャップ層とp型 した場合のスロープ効率Saはそれぞれ0.34W/A 30 2nSeキャップ層8との接合部においてp型2nSe キャップ層8側に形成される空乏層内に、p型2nTe から成る量子井戸層とp型ZnSeから成る障壁層とを 交互に積層した構造の多重量子井戸 (MQW) 層を設 け、このMQW層のそれぞれの量子井戸層の厚さをその 量子準位がp型ZnSeおよびp型ZnTeの価電子帯 の頂上のエネルギーとほぼ等しくなるように選び、これ らの量子準位を介して正孔を共鳴トンネリングにより伝 導させるようにしてもよい。このようにすれば、p側電 極10のコンタクト特性の向上を図ることが可能であ

> 【0102】また、上述の第1実施例~第5実施例にお いては、p型ZnSe光導波層6、p型Zni-。Mg。 Se Sei-a クラッド層7、p型2nS, Sei-、層1 2およびp型2nSeキャップ層8のp型不純物として のNのドーピングはECRにより発生されたN2 プラズ マを照射することにより行っているが、このNのドーピ ングは、例えば、高周波プラズマにより励起されたNz を照射することにより行うようにしてもよい。

> 【0103】さらに、上述の第1実施例~第5実施例に

ているが、この化合物半導体基板としては、例えばGa P基板などを用いてもよい。

[0104]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、乙nMgSSe系化合物半導体をクラッド層の材料 として用いた、青色ないし緑色で発光が可能な低しきい 値電流の半導体レーザーを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1 実施例による半導体レーザーを 示す断面図である。

【図2】この発明の第1実施例による半導体レーザーの エネルギーバンド図である。

【図3】この発明の第1実施例による半導体レーザーの 光出力-電流特性の測定結果の一例を示すグラフであ る。

【図4】この発明の第2実施例による半導体レーザーに おける活性層の詳細構造を示す断面図である。

【図5】この発明の第2実施例による半導体レーザーの 活性層のエネルギーパンド図である。

【図6】この発明の第3実施例による半導体レーザーを 20 6 p型ZnSe光導波層 示す断面図である。

【図7】この発明の第5実施例による半導体レーザーを 示す断面図である。

【図8】この発明の第5 実施例による半導体レーザーを 示す断面図である。

【図9】この発明の第5実施例による半導体レーザーの 室温における光出力―電流特性の測定結果の一例を示す グラフである。

【図10】この発明の第5実施例による半導体レーザー

の室温における発光スペクトルの測定結果の一例を示す グラフである。

28

【図11】この発明の第1実施例の変形例を説明するた めの断面図である。

【図12】この発明の第2実施例の変形例を説明するた めの断面図である。

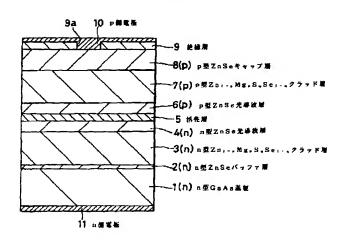
【図13】 DH構造を有する半導体レーザーおよびSC H構造を有する半導体レーザーのしきい値電流密度の活 性層の厚さ依存性を計算により求めた結果を示すグラフ である。

【図14】DH構造を有する半導体レーザーにおける厚 さ70nmのZnSSe括性層からのフォトルミネッセ ンス強度の減衰曲線を示すグラフである。

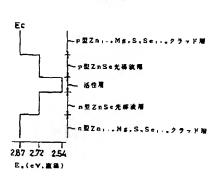
【符号の説明】

- 1 n型GaAs基板
- 2 n型ZnSeパッファ層
- 3 n型Zn_{1-p} Mg_p S_q Se_{1-q} クラッド層
- 4 n型ZnSe光導波層
- 5 活性層
- 7 p型Zni-, Mg, S, Sei-, クラッド層
- 8 p型ZnSeキャップ層
- 9 絶縁層
- 9 a 閉口
- 10 p側電極
- 11 n側電板
- 12 p型ZnS, Se1-, 層
- 13 Ala Os 膜
- 14 Si膜

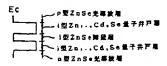
【図1】

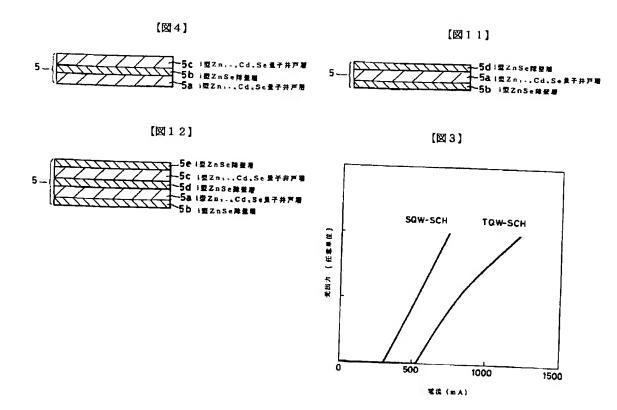


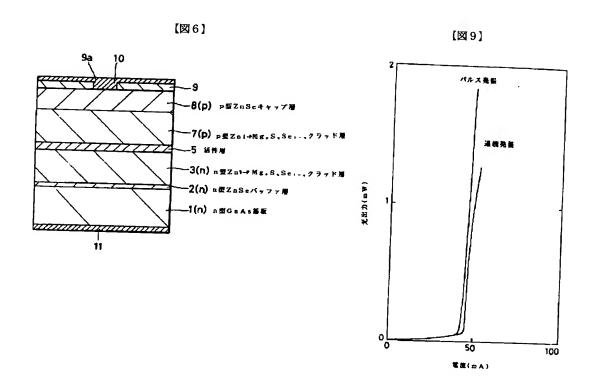
[図2]



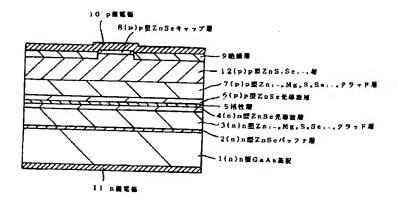
[図5]





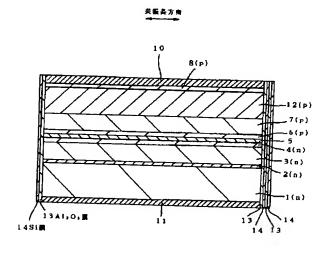


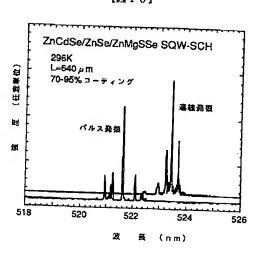
【図7】



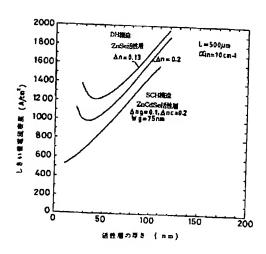
[図8]

【図10】

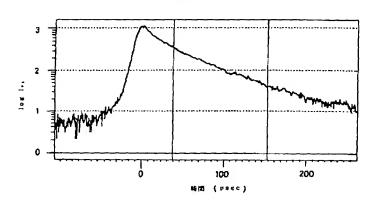




【図13】







フロントページの続き

(72)発明者 中山 典一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内